

삼성전기, 중국 MLCC 공장 가동

1500억원 투입 전자부품 양산 ... 일본 무라타와의 경쟁 본격화

삼성전기는 중국 텐진의 빈하이신구에서 빈하이 공장 준공식을 열고 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 전자부품 양산을 시작한다고 9월19일 발표했다.

MLCC는 전자제품 전류량을 조절하고 불필요한 신호를 제거하는 부품으로, 삼성전기는 일본 무라타와 함께 세계시장 점유율 1·2위를 다투고 있다.

준공식에는 박종우 삼성전기 사장, 박기석 삼성엔지니어링 사장 등 삼성 관계자를 비롯해 하립봉 텐진시 부서기, 하수산 TEDA(텐진경제기술개발구) 주임 등 중국 인사들이 참석했다.

빈하이 공장은 1993년 설립한 삼성전기 텐진법인 근처에 약 1500억원을 투입해 연면적 5만9500㎡로 건설됐다.

삼성전기는 2020년까지 7억달러를 투자해 빈하이 공장을 세계 최대의 칩 부품 전문 공장으로 육성하고 텐진 중심의 기존 공장은 연구개발(R&D)과 기술 거점으로 활용할 계획이다.

박종우 사장은 “빈하이 공장 건설로 고부가 칩 부품의 안정적인 현지 공급처를 확보하게 됐다”며 “수요가 확대되는 중국 전자부품 시장에 적극 대응해 글로벌 시장 지배력을 높ی겠다”고 강조했다.

경쟁기업인 일본 무라타도 최근 동남아시아 공장 신축 계획을 밝혀 삼성전기와 치열한 싸움이 예상되고 있다.

삼성전기는 무라타로부터 MLCC 특허 침해 소송을 당했지만 4월 미국 국제무역위원회(ITC)에서 <무라타의 특허 자체가 무효>라는 판결을 받아내 무라타에 대해 완전한 승리를 거둔 바 있다.

무라타는 불과 3년 전까지도 세계시장을 석권했지만 후발인 삼성전기가 빠르게 추격하면서 지금은 세계시장 1·2위를 놓고 경쟁하고 있다.

무라타는 최근 MLCC 가격 하락폭이 커 전반적으로 수익성이 악화되고 있는 가운데 원가 절감을 위해 일본 생산비중을 낮추고 있다.

삼성전기 관계자는 “앞으로 기존 IT시장은 물론 스마트폰과 태블릿PC 같은 고부가가치 시장에 집중하면서 새로운 성장엔진을 육성하는 투트랙 전략을 구사해 시장지배력을 계속 확대해나갈 방침”이라고 밝혔다.

아울러 “자동차 전장과 네트워크 장비 등 IT 이외 부문 매출비중을 2010년 5%대에서 2011년 10% 이상으로 끌어올리는 것을 비롯해 앞으로도 비IT 사업 비중을 크게 높여나갈 계획”이라고 밝혔다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2011/09/20>